

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5847343

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
YAN LI	11/27/2019
HYUNSUK LEE	11/27/2019
JAEWON YOO	11/27/2019
YONGJIN KIM	11/27/2019
GI-RA YI	11/28/2019
YI-RANG LIM	11/28/2019
SEUNG-HYUN KIM	11/28/2019

RECEIVING PARTY DATA

Name:	AMOREPACIFIC CORPORATION
Street Address:	100, HANGANG-DAERO, YONGSAN-GU
City:	SEOUL
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF
Postal Code:	04386
Name:	RESEARCH & BUSINESS FOUNDATION SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY
Street Address:	2066, SEOBU-RO, JANGAN-GU
City:	SUWON-SI, GYEONGGI-DO
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF
Postal Code:	16419

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	16618274

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (202)293-7068

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 2022937060

Email: sughrue@sughrue.com, bgalvez@sughrue.com

Correspondent Name: SUGHRUE MION, PLLC

Address Line 1: 2000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.

Address Line 2: SUITE 900

PATENT

Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20006
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	Q251688
NAME OF SUBMITTER:	BYRON F. GALVEZ
SIGNATURE:	/Byron Galvez/
DATE SIGNED:	12/03/2019
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).
Total Attachments: 4 source=Q251688AssignmentwithDeclarationexecuted#page1.tif source=Q251688AssignmentwithDeclarationexecuted#page2.tif source=Q251688AssignmentwithDeclarationexecuted#page3.tif source=Q251688AssignmentwithDeclarationexecuted#page4.tif	

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

특허 출원 관련 양도 및 선언 (연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

Korean Language Assignment with Declaration

이하 양도인으로 지칭되는 하기 서명 발명자인 본인(들)은 아래에 명시된 출원에서 서술한 특정 개선을 발명하였으므로 그리고

에 소재한 (양수인)은(은) 출원 및 발명의 그리고 이에 따라 획득될 일체의 미국 특허에 대한 모든 권리, 소유권 및 이권을 획득하기를 원하므로,

이제 대가를 위한 그 수평을 인정합니다.

상기 양도인인 본인(들)은 상기 명칭의 양수인, 그 승계자 및 그 양수인에게 모든 분할과 그 연속을 포함하여 미국 용으로 공개된 출원과 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든 특허증서와 미합중국 코드 제 35장 제119항에 의거한 우선권 청구권과 과거의 손해에 대한 소송권을 포함한, 개정된 파리 국제협약(1883)에 의거한 우선권을 포함한 모든 그 제발행과 모든 외국에 대한 전체 권리, 소유권 및 이권을 판매, 양도 및 이전하며 그리고 본인(들)은 출원서에 제시된 발명에 대해 승인된 일체의 특허증서를 양수인, 그 승계자 또는 그 양수인에게 발급하도록 미국 특허청장에게 요청하는 바이며 또한 본인(들)은 양수인이 본 발명에 대한 외국 특허증서를 신청할 수 있다는 데 동의하며, 본인(들)은 양수인의 요청할 경우 미국 및 외국 출원과 관련하여 양수인이 필요하다고 생각하는 모든 서류를 더 이상의 보수 없이 서명날인할 것입니다.

(공인은 기록을 위해 요구되지는 않지만 미합중국 코드 제 35장 제261항에 의거 서명날인에 대한 일종의 증거입니다)

본인은 아래 서명의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.

본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다.

- 첨부출원 또는
- 미합중국 출원 또는 PCT
국제출원 번호: _____
출원일: _____

본 출원의 제목은 다음과 같습니다:

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and

Whereas, Amorepacific Corporation of 100, Hangang-daero Yongsan-gu, Seoul, 04386, Republic of Korea; and

RESEARCH & BUSINESS FOUNDATION SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY of 2066, Seobu-ro, Jangnang-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16419, Republic of Korea, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, and all countries foreign thereto, including rights of priority under the International Convention of Paris (1883) as amended, including the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we hereby agree that the assignee may apply for foreign Letters Patent on the invention and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States and foreign applications when called upon to do so by the assignee.

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

- The attached application, or
- United States Application or PCT International Application Number PCT/KR2018/006133 filed on May 30, 2018.

The application is entitled:

METHOD FOR PREPARING POROUS INORGANIC PARTICLES

Korean Language Assignment with Declaration

위에 표시된 출원은 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를 받았습니니다.

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동 발명자라고 믿습니니다.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 검토하였으며 아울러 이해합니니다.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

본인은 연방 규정 코드 제 37장 제 156항에 규정된 바에 따라, 특허성의 판단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허청에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니다.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

본 양도 및 선언서 내에 의도적 허위 진술이 있을 경우 미합중국 코드 제 18 장의 1001 항에 의거 벌금이나 5년 이하의 징역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니니다.

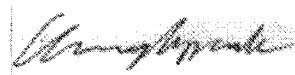
I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

AMOREPACIFIC

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature



Date

March 17, 2014

AMOREPACIFIC 김연식

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR: 단독 혹은 최초 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외) Yan		Family Name or Surname 성(姓) LI
Inventor's signature 발명자의 서명 Yan Li		Date 일자 2019-11-27
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: c/o Amorepacific R&D Center, 1920, Yonggu-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17074, Republic of Korea		
NAME OF SECOND INVENTOR: 두번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외) Hyunsuk		Family Name or Surname 성(姓) LEE
Inventor's signature 발명자의 서명 Lee, Hyunsuk		Date 일자 2019/11/27
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: c/o Amorepacific R&D Center, 1920, Yonggu-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17074, Republic of Korea		
NAME OF THIRD INVENTOR: 세번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외) Jaewon		Family Name or Surname 성(姓) YOO
Inventor's signature 발명자의 서명 YOO JAEWON		Date 일자 2019.11.27
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: c/o Amorepacific R&D Center, 1920, Yonggu-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17074, Republic of Korea		
NAME OF FOURTH INVENTOR: 네번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외) Yongjin		Family Name or Surname 성(姓) KIM
Inventor's signature 발명자의 서명 Kim, Yongjin		Date 일자 2019-11-27
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: c/o Amorepacific R&D Center, 1920, Yonggu-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17074, Republic of Korea		
NAME OF FIFTH INVENTOR: 다섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외) Gi-Ra		Family Name or Surname 성(姓) YI
Inventor's signature 발명자의 서명 YI, Gi-Ra		Date 일자 2019.11.28
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #6301-2403, 60, Central park-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16504, Republic of Korea		

NAME OF SIXTH INVENTOR: 여섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Yi-Rang	Family Name or Surname 성(姓)
		LIM
Inventor's signature 발명자의 서명	YI-RANG LIM	Date 일자
		2019/11/28
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #2216, Uikwan, Sungkyunkwan University dormitory, Natural Science Campus, 2066, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16419, Republic of Korea		
NAME OF SEVENTH INVENTOR: 일곱번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Seung-hyun	Family Name or Surname 성(姓)
		KIM
Inventor's signature 발명자의 서명	Seung Hyun Kim	Date 일자
		2019. 11. 28
Residence: 거주지: Daejeon, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #303, Namchon, 3, Sinseong-ro 58beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, 34117, Republic of Korea		